

	A 室	B 室	C 室
9:30	<p><b>【1A1】先端フリップチップ実装技術</b> 座長：西田秀行（三星電機）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>高密度エリアバンパ接続のためのコンプライアントバンパ 渡辺直也, 小島文明, 浅野種正（九州工業大学）</li> <li>ソルダーボールシート転写工法の装置開発によるプロセス技術開発の確立 土門孝彰, 佐藤広宣（TDK）, 倉本武夫, 鶴田加一（千住金属工業）</li> <li>加熱超音波ツールによる高品質フリップチップ接合技術の開発 岡崎 誠, 楡作雅史（パナソニック ファクトリーソリューションズ）</li> <li>アンダーフィル粘弾性解析によるフリップチップ接続バンパの熱疲労寿命予測 近藤 卓, 平田一郎（日本電気）</li> </ol>	<p><b>【1B1】回路基板材料—高分子材料—</b> 座長：江間富世（パナソニックモバイルコミュニケーションズ）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PEEK系熱可塑性樹脂フィルムを用いた高性能基板の開発 山田神月, 中村雄二, 鍛冶屋敷誠, 吉川和夫, 黒崎礼郎, 鈴木隆信（三菱樹脂）</li> <li>キャスト法 LCP フィルムを用いた高密度実装基板への展開 伊藤豊誠, 岡本 敏（住友化学）</li> <li>液晶ポリマー銅張板を用いた基板加工方法の検討 大幡裕之, 福武素直, 栗原康浩（ジャパンゴアテックス）</li> <li>液晶ポリマー銅張積層板の特性と実用化技術 荒井昭平（新日鐵化学）</li> </ol>	<p><b>【1C1】フレキシブルプリント基板</b> 座長：榎本 亮（イビデン）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>高密度多層 FPC の開発 小杉浩充, 佐藤裕樹, 榎 裕一（住友スリーエム）</li> <li>フレキシブル基板の変形による特性インピーダンスの変化 森川裕行（山下マテリアル）, 高橋 淳（福島県ハイテクプラザ）, 伊藤健一（イトケン研究所）</li> <li>FPC における CCL（銅張積層板）層の違いの電気的信頼性への影響 大関裕樹, 吉原佐知雄, 白根高史（宇都宮大学）</li> <li>アルカリ性電解水を用いたパラジウム核形成 吉池 潤, 竹ノ内敏一, 若林信一（新光電気工業）</li> </ol>
10:55	<p><b>【1A2】高機能対応パッケージング技術</b> 座長：齊藤雅之（東芝）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>フリップチップ実装構造における Si チップ内残留応力の構造支配因子 上田啓貴, 三浦英生（東北大学）</li> <li>信号線路構造と電源供給の工夫による 0.18 μm ノード CMOS インバータの 6 Gbps 動作の確認 今村 匠, 秋山 豊（明星大学）, 伊藤恒夫（エクセルサービス）, 伊東恭二（ルネサス北日本セミコンダクタ）, 大塚寛治（明星大学）</li> <li>薄コア基板向けパッケージング技術 福園健治, 吉村英明, 小出正輝, 佐藤裕尚（富士通）, 阿部健一郎, 藤崎秀彦（富士通インターコネクテックノロジーズ）</li> <li>小型無線モジュール用マイコンの WL-CSP 化技術 助川裕一, 村山仁孝（日立マクセル）, 田中俊明（日立化成工業）, 塚本博之, 岸本清治（日立マクセル）</li> </ol>	<p><b>【1B2】回路基板材料—導体・薄膜—</b> 座長：福岡義孝（ウェイスティール）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>高密度配線に向けたプロファイルフリー銅箔技術 小川信之, 上山健一, 田邊貴弘, 小野関 仁, 熊倉俊寿（日立化成工業）</li> <li>フレキシブル基板用圧延銅箔の特性 洗川智洋, 小野俊之（日鉱金属）</li> <li>配線用銅薄膜機械特性の製造方法依存性の検討 作谷和彦, 玉川欣治, 三浦英生（東北大学）</li> <li>スパッタ法による AlN 薄膜の作製とサブマウントへの応用 塩野晃宏, 原田佳和, 中久木政秀, 山上朋彦, 林部林平, 阿部克也, 上村喜一（信州大学）, 小畑元樹, 水間 功（シチズンファインテック）</li> </ol>	<p><b>【1C2】回路基板—評価・シミュレーション—</b> 座長：友景 肇（福岡大学）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>多層基板の耐 CAF（Conductive Anodic Filament）性評価 久世晶子, 青木雄一, 戸井恵子（エスベック）</li> <li>感光性ポリイミドを用いた 10 Gbps 高密度微細配線インターポーザの作製プロセス 大里啓孝, 伊藤千子, 菊地克弥, 瀬川繁昌, 所 和彦, 仲川 博, 青柳昌宏（産業技術総合研究所）</li> <li>マルチワイヤ配線板の高速差動伝送特性に及ぼす信号線交差の影響 太田浩司, 有家茂晴（日立化成工業）, 生井栄作（日立化成エレクトロニクス）</li> <li>高速差動バス配線での製造公差解析 鶴田信博（東芝デジタルメディアエンジニアリング）, 常盤 豪, 須藤俊夫, 西田義広（東芝）</li> </ol>
<p>昼休み</p>			
13:15	<p><b>【1A3】接合信頼性</b> 座長：苅谷義治（物質・材料研究機構）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>リフロー/フロー混載実装における IC リード剥離メカニズム 出田吾朗, 田邊 剛, 村井淳一（三菱電機）, 菅沼克昭（大阪大学）</li> <li>電子デバイスの落下試験における基板固定用ジグとプリント基板の相互作用 于 強, 鶴澤俊浩, 柴田豪紀, 白鳥正樹（横浜国立大学）, 片平孝祥（ノキアジャパン）</li> <li>BGA はんだ接続部衝撃強度の負荷時間依存性 矢口昭弘（日立製作所）, 山本健一, 木本良輔, 山田宗博（ルネサステクノロジー）</li> <li>高速剪断によるはんだ接合部の耐衝撃強度評価方法 梶原良一, 守田俊章（日立製作所）</li> <li>電子デバイスはんだ接合部の信頼性における設計因子の影響評価及びメカニズムの解明 于 強, 陳 在哲, 阿部浩和, 小山隆宏, 白鳥正樹（横浜国立大学）</li> <li>BGA 鉛フリーはんだ接合部の信頼性に対するボイドの許容基準 于 強, 小林祐介, 澁谷忠弘, 白鳥正樹（横浜国立大学）</li> </ol>	<p><b>【1B3】実装信頼性・評価</b> 座長：齊藤雅之（東芝）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>サブミクロン Au 粒子を用いた Au 焼結体マイクロ接合構造の熱疲労信頼性評価 于 強, 澁谷忠弘, 藤澤良知（横浜国立大学）, 鶴見和則, 小柏俊典, 宮入正幸（田中貴金属工業）</li> <li>鉛フリーはんだ BGA 接合部の振動負荷寿命への熱サイクル負荷の影響 松嶋道也, 川合 有, 福田恭平, 安田清和, 藤本公三（大阪大学）</li> <li>光学式デジタル画像相関法を用いたひずみ計測による鉛フリーはんだ接合部の熱疲労信頼性予測 陳 在哲, 于 強, 澁谷忠弘（横浜国立大学）, 谷村利伸（小松製作所）, 白鳥正樹（横浜国立大学）</li> <li>Sn-3.0Ag-0.5Cu の Anand モデルの材料定数算出手法に関する研究 京極好孝, 加我由佳里, 石橋正博（日本電気）</li> <li>エリアアレイ実装構造における Si チップ局所変形支配構造因子の検討 佐藤祐規, 三浦英生（東北大学）</li> <li>プリント基板の衝撃信頼性解析 館野 正, 伊東紳孝, 長竹真美, 谷口文彦, 熊谷欣一（富士通）</li> </ol>	<p><b>【1C3】部品内蔵基板</b> 座長：天明浩之（日立製作所）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>キャパシタ内蔵プリント配線板とその高周波特性 内海 茂（三菱電機）</li> <li>Ta 陽極酸化膜キャパシタの電極構造と電気特性の評価 山崎智生, 清水規良, 菅原幸紀, 六川昭雄, 飯島隆廣（新光電気工業）</li> <li>チップ部品内蔵配線板の開発 笹岡賢司, 森岡直樹（大日本印刷）, 福岡義孝（ウェイスティール）</li> <li>エンベデッド有機モジュール技術の開発 宮崎政志, 宮崎正和, 猿渡達郎（太陽誘電）</li> <li>ウエハレベル CSP 技術を応用したパッケージ内蔵型インダクタ・キャパシタ技術開発 小林知永, 滝田雄三, 伊東春樹, 高田 豊, 高木成和, 橋元伸晃（セイコーエプソン）</li> <li>樹脂基板への部品内蔵に関する電気的特性の検討 中瀬康一郎, 堺 淳, 大島大輔, 井上博文（日本電気）</li> </ol>
15:15	<p>表彰式 MES 2004</p>	<p><b>【受付】1 階 エントランスホール</b> <b>【セッション会場】</b> A 室：3 階 MO ホール B 室：2 階 会議室 2 C 室：2 階 会議室 3 <b>【カタログ展示コーナー】1 階 エントランスホール</b></p>	
15:30	<p>招待講演 座長：菅沼克昭（大阪大学）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次世代微細回路形成へのナノテクノロジーの応用 繩舟秀美（甲南大学理工学部教授）</li> <li>カーエレクトロニクスを支える実装技術への期待 服部雅之（トヨタ自動車第 3 電子技術部 31 電子室室長）</li> </ol>		
17:00			

18:00	<p>交流会 会 場：千里阪急ホテル（千里中央駅から徒歩約 5 分）* MES 会場から専用バスを運行する予定です。 仙寿の間（ホテル 2 階） 参加費：5,000 円（消費税込み）* MES 参加費には含まれておりません。</p>
20:00	

	A 室	B 室	C 室
9:10	<p>(9:30)</p> <p><b>【2A1】システム・イン・パッケージ技術</b> 座長: 佐藤了平 (大阪大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>貫通電極を有した三次元モジュール開発 横山好彦, 原 一巳, 伊東春樹, 深澤元彦, 橋元伸晃 (セイコーエプソン)</li> <li>高密度チップ間接続構造パッケージの開発 栗田洋一郎, 副島康志 (NEC エレクトロニクス), 菊池 克, 高橋尚武, 田子雅基 (日本電気), 小池昌弘, 森下佳昭 (NEC エレクトロニクス), 山道新太郎 (日本電気), 川野連也 (NEC エレクトロニクス)</li> <li>貫通配線基板の伝送特性 松丸幸平, 山本 敏, 橋本幹夫, 定方伸行 (フジクラ)</li> <li>シリコンインターポーザーの基礎評価 小泉直幸, 白石晶紀, 春原昌宏, 坂口秀明, 東 光敏 (新光電気工業)</li> </ol>	<p><b>【2B1】回路基板—プロセス技術—</b> 座長: 馬場和宏 (日本電気)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>アンモニア系アルカリ溶液による回路用銅箔のウェットエッチング特性 高橋大喜, 松村和俊, 松本克才, 谷口尚司 (東北大学)</li> <li>ビラブル銅箔を用いた LGA タイプ超薄型パッケージの開発 珍田 聡, 宮本宣明 (日立電線), 平沢宏希, 内田建次 (NEC 化合物デバイス)</li> <li>ダイレクトレーザ加工法における銅表面処理と加工性について 中村幸子, 栗井良浩, 中村真美, 中島慶一, 市橋知子 (メック)</li> <li>プラズマを用いたデスマ処理の圧力依存性に関する研究 倉橋孝宏 (ニッシン), 加藤聖隆 (ケイテックリサーチ)</li> <li>低熱膨脹 LTCC による低応力実装技術 前田和孝, 古久保洋二, 國分正也 (京セラ)</li> </ol>	<p><b>【2C1】めっき技術—回路形成—</b> 座長: 赤松謙祐 (甲南大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>フィールドビア電気銅めっきにおける Cu(I) の回転リングディスク電極を用いた作用メカニズム解析 大久保利一 (凸版印刷), 渡辺恵司 (大阪府立大学), 畑井一成 (岡山大学), 近藤和夫 (大阪府立大学)</li> <li>PR 電解を用いたフィールドビアめっきの作製 中村太一, 三上大輔 (大阪府立大学), 大久保利一 (凸版印刷), 近藤和夫 (大阪府立大学)</li> <li>金属ナノ粒子の光活性化作用を利用した無電解銅めっき 寺田信人, 松葉頼重 (ハリマ化成)</li> <li>光触媒を前処理に用いたビルドアップ絶縁材料への無電解銅めっき 井上浩徳 (関東学院大学), 石川久美子 (関東学院大学表面工学研究所), 別所 毅 (トヨタ自動車), 小岩一郎 (関東学院大学), 本間英夫 (関東学院大学表面工学研究所)</li> <li>厚付け置換 Sn めっきプロセスの開発 伊内祥哉, 田中 薫, 内田 衛 (石原薬品)</li> </ol>
10:55	<p><b>【2A2】次世代先進実装技術</b> 座長: 森 三樹 (東芝)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>プラズマ照射による大気中での Flux-less フリップチップ接合技術の開発 青柳哲理, 海老塚守之 (ソニー), 佐藤充弘 (ソニーセミコンダクタ九州)</li> <li>MEMS デバイス貫通孔配線技術の開発 北嶋雅之, 松山良治, 十倉史彦 (富士通)</li> <li>発表中止</li> <li>液体金属を用いた界面の常温分離技術 細田奈麻絵, 木村 隆 (物質・材料研究機構), 須賀唯知 (東京大学)</li> </ol>	<p><b>【2B2】接合信頼性—接合耐久性—</b> 座長: 上西啓介 (大阪大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ガルウィング形表面実装部品における鉛フリーはんだ接合部の引きはかり強度 早川 潔 (日本ビクター), 高橋浩之 (東芝), 佐々木喜七 (日本電子部品信頼性センター), 高橋邦明 (東芝)</li> <li>表面実装部品における鉛フリーはんだ接合部のせん断強度 古野雅彦 (タムラ製作所), 川上 崇 (東芝), 渡辺浩幸 (TDK), 木下裕章 (日本航空電子工業), 加藤光明 (太陽誘電), 佐々木喜七 (日本電子部品信頼性センター), 高橋邦明 (東芝)</li> <li>表面実装部品における鉛フリーはんだ接合部の繰返し落下衝撃強度 気賀智也, 佐々木晃司 (ソニーイーエムシーエス), 干 強 (横浜国立大学), 佐々木喜七 (日本電子部品信頼性センター), 高橋邦明 (東芝)</li> <li>鉛フリーはんだ接合部の繰返し曲げ強度試験 田中秀典 (東芝デジタルメディアエンジニアリング), 苅谷義治 (物質・材料研究機構), 佐々木喜七 (日本電子部品信頼性センター), 高橋邦明 (東芝)</li> </ol>	<p><b>【2C2】めっき技術—皮膜・接合特性—</b> 座長: 松岡政夫 (立命館大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>陽電子消滅法を用いためっき銅中の格子欠陥の研究 穴戸逸朗, 松尾明彦, 豊山裕夫, 水野正隆, 荒木秀樹, 白井泰治 (大阪大学)</li> <li>Ni-P/Pd/Au 及び Ni-P/Au 皮膜上への Sn/Ag/Cu はんだ接合時における接合界面の観察 村角明彦, 小田幸典, 木曾雅之, 橋本滋雄 (上村工業)</li> <li>孔食のない新規非シアン系置換型無電解銅めっきのはんだボール接合強度, 及び接合界面の構造 相場玲宏, 河村一三 (日鉱マテリアルズ), 渋谷宏明 (日鉱メタルプレATING)</li> <li>無電解銅めっき皮膜特性におよぼす下地めっきの影響 角田貴徳, 長島弘季, 寺島 肇 (関東学院大学), 渡辺秀人 (小島化学薬品), 小岩一郎 (関東学院大学), 本間英夫 (関東学院大学表面工学研究所)</li> </ol>
12:15			
<b>昼休み</b>			
13:05	<p><b>【2A3】鉛フリーはんだ</b> 座長: 竹本 正 (大阪大学)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ウイスカ抑制 Pb フリーはんだ合金 林田喜任, 高橋義之, 大野隆生 (タムラ化研), 荘司郁夫 (群馬大学)</li> <li>鉛フリー Sn 系めっきのウイスカ発生要因の考察 森内裕之, 田所義浩 (第一電子工業), 鈴木 昇, 佐藤正秀, 古澤 毅 (宇都宮大学)</li> <li>発表中止</li> <li>はんだ接合強度向上はんだペースト 柏木慎一郎, 櫻井 均, 隈元聖史 (ハリマ化成)</li> <li>鉛フリーはんだによるフロー槽侵食現象と対策 百川裕希, 真船則夫, 石塚直美, 鈴木元治, 村上朝夫, 松井孝二 (日本電気)</li> <li>高温用鉛フリーはんだ Zn-xSn と Zn-30In 合金の微細組織と引張強度特性 李 在彦, 金 權錫, 菅沼克昭 (大阪大学)</li> </ol> <p style="text-align: right;">(15:05)</p>	<p><b>【2B3】光インタコネクション</b> 座長: 小池真司 (日本電信電話)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>微細周期構造を有する光導波路システム実設計のための損失評価 木村晃也, 安田清和, 松嶋道也, 藤本公三 (大阪大学)</li> <li>マスク形成による自己形成光導波路を応用した光表面実装デバイス 小幡雄介, 藤田信也, 神田昌弘, 小澤秀明, 三上修, 内田慎二 (東海大学)</li> <li>自己形成光導波路を用いた V スロット光導波路間接続 小澤秀明, 小幡雄介, 三村祐介, 花島 宏, 三上修 (東海大学), 塩田剛史 (三井化学)</li> <li>多芯光ビーンによる 90 度光路変換部品の Semi-Passive 表面実装への検討 陳 利益 (イビデン), 三上 修 (東海大学)</li> <li>VCSSEL の高次出射モードを考慮した光結合効率算出のための基礎評価 若園芳嗣, 菊地克弥, 鈴木 敦, 鈴木健司, 鈴木修司, 山口隆行, 仲川 博, 茨木 修, 青柳昌宏 (産業技術総合研究所)</li> <li>新規実装構造を有する 10 Gb/s×4 ch インターコネクションモジュール 鈴木健司, 若園芳嗣, 鈴木 敦, 鈴木修司, 山口隆行, 菊地克弥, 仲川 博, 茨木 修, 青柳昌宏 (産業技術総合研究所)</li> <li>光バックプレーンのための 10 Gbps 伝送用評価基板の設計と評価 鈴木 敦, 若園芳嗣, 鈴木健司, 菊地克弥, 仲川博, 鈴木修司, 山口隆行, 茨木 修, 青柳昌弘 (産業技術総合研究所)</li> </ol>	<p><b>【2C3】表面処理—基板と回路—</b> 座長: 中岸 豊 (奥野製業工業)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ITO 膜の還元劣化現象 山浦 潔 (ソニー)</li> <li>高精細パターンにおける残液処理技術の開発 冨山浩二 (東レエンジニアリング)</li> <li>スパッタリング法を用いた低誘電率材料と金属の高接着技術の検討 松浦雅晴, 井上文男, 清水 明, 伊藤豊樹, 山下智章, 井上康雄, 中祖昭士 (日立化成工業)</li> <li>低誘電樹脂と高接着可能な新規銅配線表面処理の検討 山下智章, 井上文男, 中祖昭士 (日立化成工業)</li> <li>全湿式プロセスによる銅/ポリイミド界面密着構造の制御と最適化 池田慎吾, 赤松謙祐, 縄舟秀美 (甲南大学), 柳本博 (三ツ星ヘルト)</li> <li>ポリイミドフィルムの完全湿式金属化技術 長原充典 (ティアアンドケイ), 春田要一 (春田技術士事務所)</li> <li>選択的光化学析出法によるガラス基板への微細銅回路の形成 木村明寛, 赤松謙祐, 縄舟秀美 (甲南大学)</li> </ol>
15:25	<p>(15:10)</p> <p><b>【2A4】ナノテクノロジー</b> 座長: 小山賢秀 (ハリマ化成)</p>		
15:30	<ol style="list-style-type: none"> <li>半導体ナノ結晶の表面修飾と発光波長制御 鶴岡孝章, 高橋礼奈, 赤松謙祐, 縄舟秀美 (甲南大学)</li> <li>銀ナノ粒子を用いた実装プロセスの開発 山口拓人, 井出英一, 廣瀬明夫, 小林紘二郎 (大阪大学), 山際正憲, 村上善則 (日産自動車)</li> <li>金属ナノ粒子および合金ナノ粒子ペーストによるプラスチック基材への回路形成 中許昌美, 山本真理, 柏木行康 (大阪市立工業研究所), 垣内宏之, 辻本智昭, 吉田幸雄 (大研化学工業)</li> <li>インクジェット印刷による LTCC 多層配線基板への銀微細配線形成 小岩井孝二, 河村裕貴, 永田久和, 山口祥子, 田中哲郎, 佐久間敏幸, 林 琢夫 (KOA), 桜田和昭, 小林敏之, 和田健嗣 (セイコーエプソン)</li> <li>インクジェット法により作成された回路基板の電気的特性 水垣浩一, 和田健嗣 (セイコーエプソン)</li> </ol>	<p><b>【2B4】FC 接続・材料</b> 座長: 伊達仁昭 (富士通研究所)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>発表中止</li> <li>超音波フリップチップ接続用 NCF (Non Conductive Film) 榎本哲也, 永井 朗, 渡辺 治, 竹村賢三 (日立化成工業)</li> <li>塑性流動を発生する熱硬化性フィルム接着剤を用いた接続技術 川手恒一郎 (住友スリーエム)</li> <li>ポリベンゾオキサゾール (PBO) 前駆体中の塩素イオン濃度の低減方法とコロージョン 伊藤文就, 池田 修 (ソニー), 長谷川匡俊 (東邦大学)</li> </ol>	<p><b>【2C4】めっき技術—プロセス—</b> 座長: 藤原 裕 (大阪市立工業研究所)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>化学製膜 ZnO を用いたガラス基板への高密着性銅薄膜の無電解形成 大友さとみ, 片山順一 (奥野製業工業), 伊崎昌伸 (大阪市立工業研究所)</li> <li>ULSI 銅微細配線の形成を目的とした添加剤の予備吸着を利用する銅電析プロセス 尾山祐斗, 赤松謙祐, 縄舟秀美 (甲南大学), 内田衛 (石原薬品), 中尾誠一郎 (大和化成研究所)</li> <li>有機分子保護ナノ粒子を用いたガラス基板への微細金配線の形成 寺畑博晃, 赤松謙祐, 縄舟秀美 (甲南大学)</li> <li>高精細配線対応無電解銅めっき技術 納堂高明, 中島澄子 (日立化成工業), 長谷川 清 (日立化成エレクトロニクス)</li> </ol>
16:50			

\* 題名, 発表者などプログラムの内容は変更されることがあります。予めご了承ください。